

导热填缝硅胶 RH-TCG-425

特色:

- 双组分导热硅凝胶
- 低硬度, 低模量, 低应力, 高回弹
- 加成体系, 耐高温, 无小分子释放
- 常温固化或加热加速固化
- 低挥发分, 挥发性环体<300PPM
- 高热稳定性, 耐热冲击循环

产品组成

- 硅凝胶
- 无机导热填料

产品应用

- 通用性导热凝胶, 如计算芯片, 服务器等。
- 集成电路模块 PCB 导热

常见性能参数*

产品名称	RH-TCG-425
导热率 (瞬态法) W(m · K)	4.0
硬度 Shore 00	50 ± 5
A 组分粘度, mPa.s	400000
B 组分粘度, mPa.s	300000
单/双组分	双 (1: 1) 蓝/白
混合后密度 g/m	3.1 ± 0.1
介电强度, KV/mm	≥10
体积电阻率 $\Omega \cdot \text{cm}$	≥1.0*10 ¹⁴
可操作时间 min, 25 ° C	30-60
初步固化时间 min, 25 ° C	90-120

应用方法

- 自动点胶机

固化条件

- 初固: 常温 1.5-2 小时
- 完全固化: 常温 24hr 或加热固化 (e.g. 60 摄氏度 1hr, 100 摄氏度 0.5hr)

运输储存条件

双组分包装:

- 200L 铁桶包装
- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存, 最佳使用期限为 3 个月以内

产品应用温度

通常有机硅材料在很大温度范围内保持稳定，考虑到综合性能和老化影响，此系列 -25 至 150 摄氏度范围内使用可获得最佳效果。如需其他温度范围，请咨询应用工程师。

其他注意事项

- 使用表面需保持清洁
- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 如需返工，再次使用前需清洁表面
- 点胶和涂胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触